



HB Technology IR Book

Aug. 2023



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 작성 되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 자료에 포함된 '예측정보' 는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 '예측정보' 는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 '예측정보' 에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

1. Company Overview

HB 그룹은 디스플레이 장비, 부품소재(도광판/확산판), 엔터테인먼트, 창업투자, 펄프무역 등 5대 주요 사업으로 발전해 왔으며,

지주회사인 (주)HB콤팩과 5개 계열사, 중국, 대만, 베트남 등지에 해외 자회사를 운영하고 있습니다.

현재, HB테크놀러지, HB솔루션 2개사가 코스닥에 상장되어 있습니다.

	HB 테크놀러지	HB 솔루션
- 설립일 - 위치 - 대표이사 - 임직원수⁽¹⁾ - 주요 사업 - 시가총액⁽²⁾	1997년 9월 충남 아산 문성준 430명 AOI/Repair, 2차전지 검사장비, 도광판/확산판 2,395억	2001년 9월 충남 아산 이재원 251명 UTG Lami, 잉크젯, FoD, ELB, 점등검사기, MEIS 3,280억
사업장 전경		

	HB 콤팩	HB 인베스트먼트	HB 엔터테인먼트
- 설립일 - 위치 - 대표이사 - 임직원수 - 주요 사업	1975년 9월 서울 강남구 언주로 문성준 37명 펄프무역, 부동산임대	1999년 11월 서울 강남구 언주로 황유선 15명 창업투자(벤처캐피탈)	2006년 10월 서울 강남구 언주로 문보미 22명 드라마 제작, 매니지먼트

(1) 2022년 12월 31일 기준

(2) 2023년 7월 17일 기준

1. Company Overview

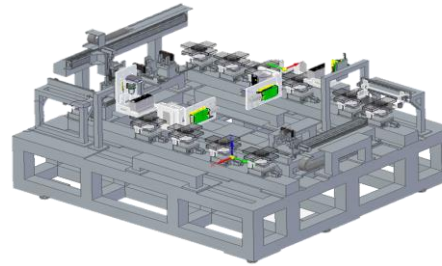
주요 사업 부문

HB테크놀러지는 디스플레이 장비(AOI, Laser Repair), 2차전지 장비, LED TV 등에 사용되는 확산판과 도광판을 주요 사업부문으로 갖고 있습니다.

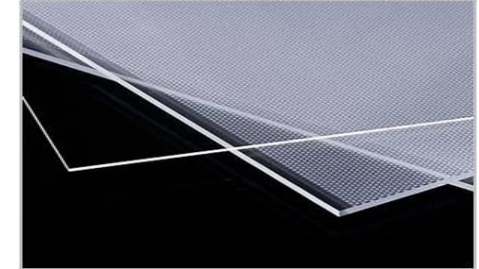
디스플레이 장비



2차전지 장비



부품소재



주요 제품

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ In-line / Stand Alone AOI▪ BP/EVEN/Mask AOI▪ Sub Micro(0.2~0.8um) AOI▪ BP Laser Repair▪ Cell Laser Repair | <ul style="list-style-type: none">▪ 각형 외관 검사기▪ 원형 셀 검사기▪ DD CAN 검사기▪ 빛감김 검사기(Module) | <ul style="list-style-type: none">▪ 도광판(LGP)▪ 확산판(DP) |
|---|---|--|

주요 Site

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ HB Tech.(아산)▪ HB Tech.(풍세2)▪ 남경법인(중국) | <ul style="list-style-type: none">▪ HB Tech.(아산)▪ HB Tech.(풍세2)▪ HB Hungary Kft.(헝가리) | <ul style="list-style-type: none">▪ HB Tech.(화성)▪ HB Tech.(풍세1) |
|---|---|--|

주요 고객

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ 삼성디스플레이▪ BOE, CSOT, 천마전자 등 | <ul style="list-style-type: none">▪ 삼성 SDI | <ul style="list-style-type: none">▪ 삼성전자 해외법인 |
|---|--|---|



1. Company Overview
2. 장비 사업 부문
3. 부품 소재 사업 부문
4. 재무현황 및 참고자료

1. 시장동향(디스플레이_국내)

“삼성디스플레이는 3가지 축으로 투자를 진행할 것으로 예상됨”

IT기기용 8.6G



중소형 6G



대형 OLED



- 삼성디스플레이는 OLED 패널의 대부분을 차지하는 스마트폰용 패널 의존도를 줄이고 IT용, 자동차용 디스플레이로 시장 확장 의지 표명
- IT혁신라인 IT_OLED 8.6G 15K/월, A4E 6G 15K/월, Q1 ph2 Gen 8.6 QD_OLED 15/월 예상됨.
- 삼성전자는 2025년까지 QD에 13조원 투자 의사 밝혔으며, 현재 Q1라인에 투입된 3조원 제외 후 10조원 가량 미집행.

국가	업체	SITE	TECH	CAPA (MAX)	투자시기	장비셋업 개시	양산개시	2023				2024				2025				2026			
								1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
한국	SDC	A4-2 Ph2	OLED	15	'24년 초	'25년 초	'25년말																
		IT 혁신	IT_OLED	15	'23.2Q	'24.1~2Q	'25.1Q																
		IT 혁신	IT_OLED	7.5~15	'24.3Q	'25.3Q	'26.4Q																
		Q1 ph2	QD_OLED	15~30	'24.2Q	'25.2Q	'26.2Q																

출처 : OLED and LCD Manufacturing and Technology Trends, 28/07/22, OMDIA

1. 시장동향(디스플레이_해외)

“중국 업체들의 지속적인 디스플레이 설비 투자 유효”

- 신종 코로나, 전쟁, 인플레이션 등 악재 속에서도 중국 업체들 신규 생산라인 구축 투자 발표
→ BOE B20(6세대 LCD 및 Mini LED, 290억 위안 규모, 2025년 양산 계획), 천마 샤먼(8.6세대 LCD, 330억 위안 규모, 2024년 양산 계획) 및 BOE 베트남 공장 구축 계획 중(4억 달러 규모, 2025년 완공 목표)
- BOE B16은 투자 지연 중이나 SDC IT혁신라인 투자 진행에 따라 가속화 가능성 有
- CSOT, Visionox는 OLED 투자를 계획하고 있으나, 일정이 구체화되진 않았음.
- 천마는 향후 78억 위안 규모 차량 및 신형 디스플레이 모듈 생산라인 증설에 대한 투자 계획 공식화

중국 디스플레이 제조사 투자 계획 전망

(단위 : 천장/월)

국가	업체	SITE	Gen	TECH	CAPA (MAX)	투자시기	장비셋업 개시	양산	2023				2024				2025				2026			
									1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
중국	TIANMA	TM18 ph2	6	OLED	16	'22.3Q	'23.3Q	'24.3Q																
	TIANMA	TM18 ph3	6	OLED	16	'24.2Q	'24.4Q	'25.4Q																
	TIAMNA	TM19	8.6	LCD	135	'22.4Q	'23.12	'24.3Q																
	CSOT	IT_OLED	8.6	OLED	15	'24.1Q	'25.01	'26.1Q																
	BOE	B20	6	LCD	180	'23.4Q	'24.4Q	'25.4Q																
	BOE	B16	8.6	OLED	30	'23.4Q	'24.4Q	'25.4Q																

출처 : OMDIA

1. 시장동향(2차전지_SDJ)

“배터리 수요 견조한 가운데 국내 배터리사 Capa 증설 지속, 장기 시장 전망 긍정적”

- 전기차 시장 호조에 따라 북미 시장 중심의 배터리사 CAPA 증설이 지속되는 가운데, 삼성SDI 또한 25년 양산 목표로 스텔란티스, GM 합작법인 설립을 발표하며 미국 시장 공략 본격화 계획 중
- 삼성SDI는 국내 배터리사 중 최초로 '23년 하반기 중 전고체 배터리 시제품 생산 예정이며 2027년 양산 목표로 제품 개발 중

※ 삼성SDI 배터리 CAPA 전망(2022~2026)

(단위 : Gwh)

구분		2022	2023F		2024F		2025F		2026F	
		누적 Capa.	누적 Capa.	당기 증가	누적 Capa.	당기 증가	누적 Capa.	당기 증가	누적 Capa.	당기 증가
삼성 SDI	총 생산능력	91	119	+28	151	+32	207	+56	283	+76
	각형	51	59	+8	91	+32	107	+16	163	+56
	울산	9	9	-	9	-	9	-	9	-
	중국	10	10	-	10	-	10	-	10	-
	헝가리	32	40	+8	48	+8	56	+8	64	+8
	미국(스텔란티스)				24	+24	32	+8	40	+8
	미국(GM)								40	+40
	원통형	40	60	+20	60	-	100	+40	120	+20
	4680		4	+4	4	-	44	+40	64	+20
	1685 & 2170 & 전동공구	35	51	+16	51	-	51	-	51	-
	기타	5	5	-	5	-	5	-	5	-

출처 : 미래에셋증권 참조

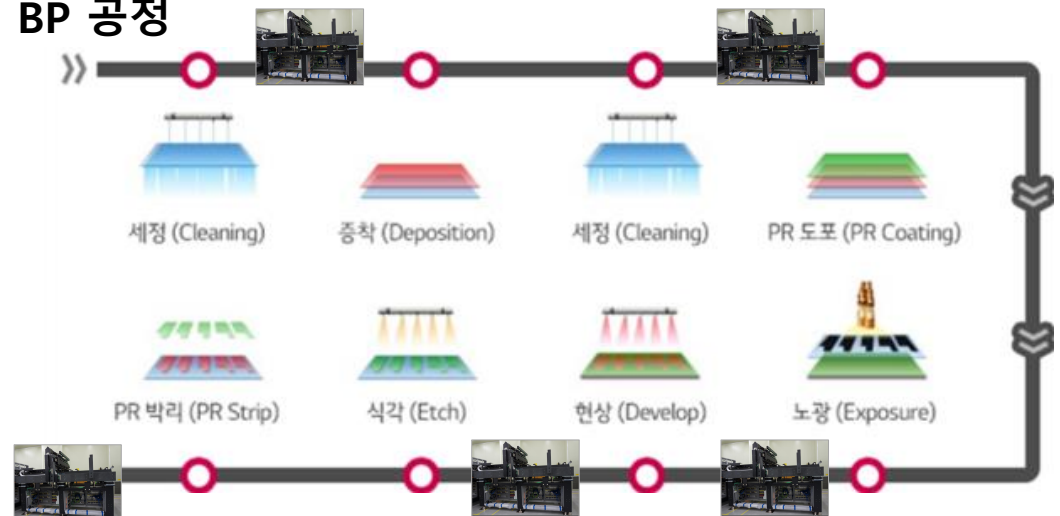
2. 주요 사업 item

AOI 장비



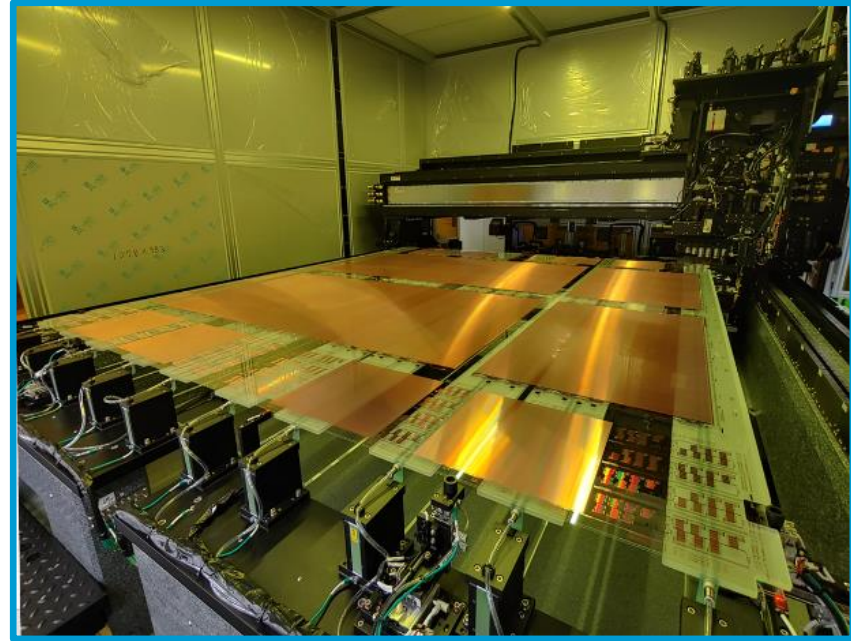
- AMOLED, TFT-LCD, Color Filter 패널 제조공정에서 발생하는 각종 결함을 고속으로 검출하는 장비
- 고객의 품질관리 및 생산성 향상을 확보하기 위한 **In-Line 장비**
- **독창적인 초고속 이미지처리 프로세스** 기술과 광학 알고리즘, 고성능 CAMERA 제어기술을 적용하여 미세 불량률을 정확하고 빠르게 검출하고 분류

BP 공정



2. 주요 사업 item

REPAIR 장비



BP Repair는 각 Layer 별로 분류된 패널을 AOI 검사 후, 검출된 Defect의 유형 분류에 따라 Laser와 Metal Ink Jetting 기술을 활용하여 패널 내 Defect 수리를 통하여 결점 제거 및 양품화 시켜 생산 수율을 향상시키는 설비

2. 주요 사업 item

2차전지 통합 외관검사기 & 빗감김 검사기

2차전지 통합 외관검사기

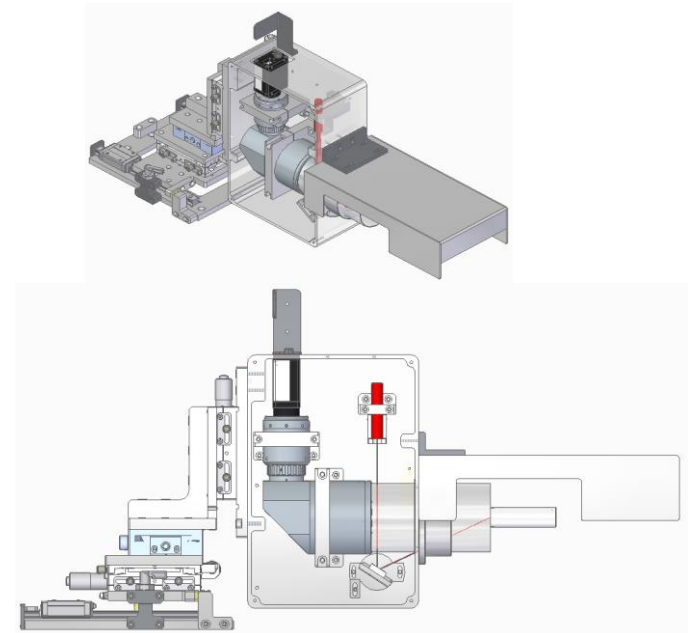


자동차용 각형 2차전지의 6면에 대한 외관불량을 검사하는 장비
Nude Cell 및 Taping Cell을 2D와 3D를 이용한 표면 검사를 통하여 불량을 검출하며,
Cell 용량 별 크기 변화에도 검사 대응이 가능

★Feature

- 적용제품 : 각형 2차전지
- 검사영역 : 상부, 하부, 전면, 후면, 좌·우측면, 모서리
- 불량명 : 용접불량, Scratch, 찍힘, 전해액 오염, 이물, 기포
- 표면 및 모서리부 불량 검출 알고리즘
- 불량 분류 세분화 및 Data화

빗감김 검사기

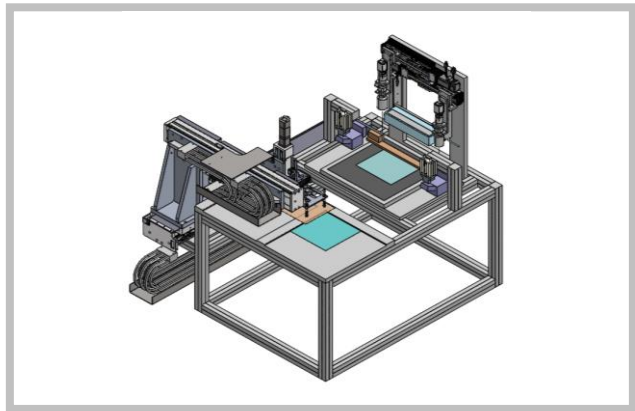


- 적용제품 : 21700 원형 Cell
- 검사방식 : 제품 단면 SCAN 검사
- 검사내용 : 원형 Cell의 Winding 공정 후 불량을 검출하는 Module
- 불량명 : 끊어짐(음극, 양극), 음극/양극 시작점 일치화 등

2. 주요 사업 item

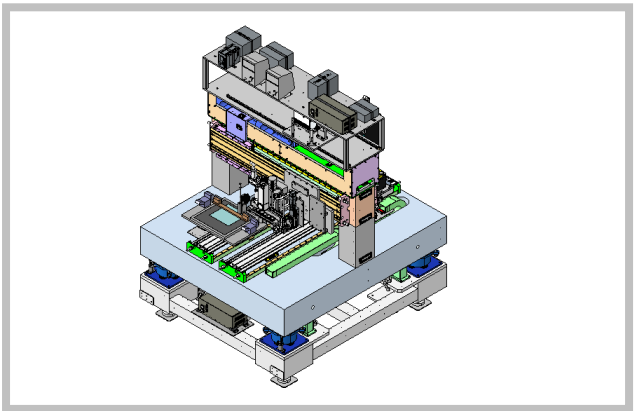
신규 프로젝트 및 개발현황

HB테크놀러지는 선도기술을 바탕으로 신규 프로젝트 수주를 적극 추진하고 있습니다. 나날이 발전하는 디스플레이 기술을 누구보다 빠르게 습득하여 기술 기업으로써 가치를 지속 창출하고자 합니다. PCB 기판 생산라인에 신규설비를 납품 계약을 체결하여 현재 제작 중이며 그 외 미래 디스플레이 기술인 마이크로 OLED와, 차세대 신 공정 장비관련 기술개발에 박차를 가하고 있습니다.



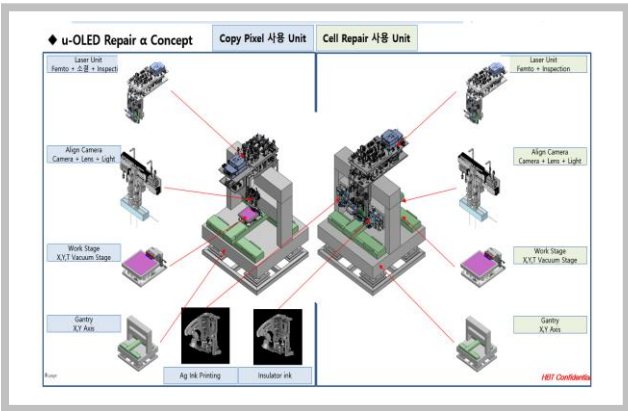
PCB용 검사 및 Repair

- ▶ 개요
 - PCB용 검사(AOI) 및 Repair 장비
- ▶ 개발 검사기
 - 패턴 검사기, Laser Repair



차세대 新공정 장비

- ▶ 개요
 - Laser 및 잉크 응용 양산 설비 진입
- ▶ 내용
 - Metal 잉크 활용한 배선연결 기술
 - Laser patterning 기술



u-OLED용 Repair 장비

- ▶ 개요
 - u-OLED 공정의 리페어 기술
 - AR, VR용 新 디스플레이 기술 확보



1. Company Overview
2. 장비 사업 부문
3. 부품 소재 사업 부문
4. 재무현황 및 참고자료

1. 주요 사업 아이템

HB테크놀러지의 부품소재 사업부는 “원판 → 커팅 → 패턴” 수직계열화를 완료하고 원가경쟁력 확보하였으며,
공장통합 이전에 따른 생산성증대, 제반 관리비용 감소, 고객관계 강화에 집중하여 30%⁽¹⁾이상의 높은 M/S를 확보하고 있습니다.

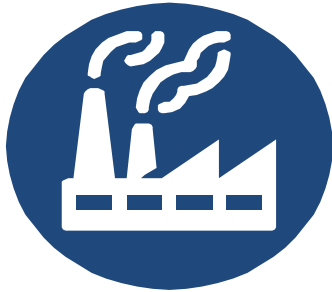


(1) 삼성전자(전세계) 도광판 수요에 대한 당사의 공급비중('21년 현재)

2. 사업경쟁력

경쟁업체 대비 사업경쟁력 우위 확보

일관생산공정



- 제일모직 압출사업부 인수
- R/S 패턴 생산체제 집중
- One Stop 생산으로 원가경쟁력 확보

기술력



- MS, PMMA Fine Lenti 압출기술
- 정밀 경면 가공 기술
- R/S 패턴 설계 및 가공 기술

글로벌 고객사



- 국내외 다양한 거래처 확보를 통한 안정적인 매출 성장 지속
- 신규 해외거래선 확보를 위한 글로벌 영업 강화



1. Company Overview
2. 장비 사업 부문
3. 부품 소재 사업 부문
4. 재무현황 및 참고자료

1. 주요 재무현황(별도 재무제표)

재무제표 및 지표

(단위: 백만원,%)

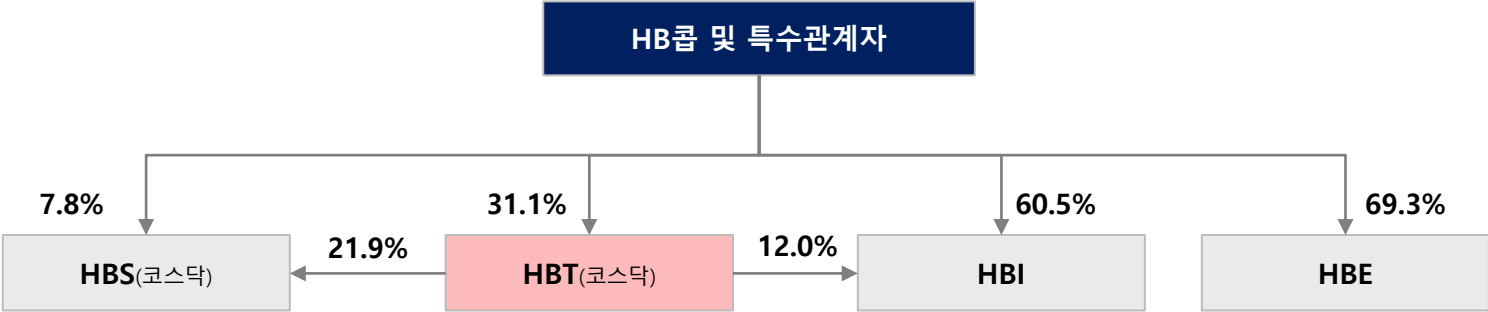
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	285,224	250,911	223,722	243,263	144,418	141,623
영업이익	47,978	7,391	852	8,055	-19,698	2,268
%매출액	16.8%	2.9%	0.4%	3.3%	-13.6%	1.60%
감가상각비	6,353	8,002	8,869	8,902	6,576	4,797
EBITDA	54,331	15,394	9,722	16,957	-13,122	7,065
%매출액	19.0%	6.1%	4.3%	7.0%	-9.1%	4.99%
당기순이익	37,781	6,085	1,816	5,157	-9,570	20,961
현금 및 단기금융상품	74,225	27,077	23,697	33,119	32,001	18,739
유형자산	41,718	37,515	36,354	30,975	35,699	44,472
총자산	200,162	198,300	228,286	213,831	239,428	251,849
차입금	7,493	14,457	17,879	17,127	13,706	12,538
총부채	44,064	44,343	72,293	54,129	84,199	75,682
총자본	156,097	153,956	155,993	159,702	155,228	176,167
ROE	24.2%	4.0%	1.2%	3.2%	-6.2%	11.90%
ROA	18.9%	3.1%	0.8%	2.4%	-4.0%	8.32%
부채비율	28.2%	28.8%	46.3%	33.9%	54.2%	42.96%
이자비용	291	251	318	242	789	1,146
EBITDA이자보상배수	187x	61x	31x	70x	-17x	6x

2. 배당 실적

	단위	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
주당 배당금	원	30	40	20	20	20	20	20
연말 1주간 평균주가	원	5,063	3,475	2,996	2,995	2,187	2,670	1,925
시가배당률	%	0.6%	1.2%	0.7%	0.7%	0.9%	0.7%	1.0%
당기순이익	백만원	29,385	37,781	6,085	1,816	5,157	-9,570	20,961
총배당금액	백만원	2,274	3,105	1,539	1,539	1,523	1,523	1,503
배당성향	%	7.7%	8.2%	25.3%	84.7%	29.5%	-15.9%	7.2%
주당순이익	원	388	490	79	24	68	-126	276

3. Governance

지주회사 역할을 하고 있는 HB콤파를 중심으로 안정적인 지배구조를 유지하고 있습니다.



[2022년 12월 31일 기준] (단위: %)

출자회사 피출자회사	특수관계자	HB Corp.	HB Technology	HB Solution	합계
HB Corp.	100.0%	-	-	-	100.0%
HB Technology	15.2%	15.9%	-	-	31.1%
HB Solution	0.3%	7.5%	21.9%	-	29.7%
HB Entertainment	69.3%	-	-	-	69.3%
HB Investment	20.5%	40.0%	12.0%	-	72.5%

(*) 해외자회사 4개社(대만, 중국(남경), 헝가리, 베트남) 제외

End of Document